

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：券商策略会
参与单位	安信基金、宝盈基金、北京容光投资、本见投资、博时基金、财通基金、辰星投资、诚通证券、创富兆业、创金合信、慈阳投资、大成基金、大家资产、大连银行、大朴资产、淡水泉投资、德邦基金、东方财富证券、东方基金、东方资管、东吴证券、风炎投资、高维资产、高信百诺、光大永明、广发证券、广州创钰投资、国华兴益资产、国联基金、国寿安保基金、国寿养老、国寿资产、国泰海通、国泰基金、国信证券、国赞投资、果实资本、杭州传定私募基金、杭州附加值投资、昊晟基金、合众资产、和谐健康险、河南银泰投资、恒邦兆丰资管、红杉资本、宏道投资、泓澄投资、华泓资产、华金证券、华美国际投资、华能贵诚信托、华商基金、华泰保兴基金、华夏基金、华夏未来、华源证券、汇华理财、惠通基金、嘉实基金、建信理财、交银施罗德、金建投资、金域蓝湾、泾溪投资、君成投资、君子乾乾、宽源投资、乐桥资本、立心资产、利幄基金、六妙星基金、民森投资、名禹资产、明河投资、明世伙伴、摩根基金、摩根士丹利基金、南方基金、南方天辰投资、宁波宝隼资产、诺安基金、盘京投资、磐泽资产、鹏华基金、前海联合基金、钦沐资产、青骊投资、清源投资、泉果基金、人保资产、睿扬投资、熵盈基金、上海呈瑞投资、上海递归私募基金、上海合远、上海河清龙樾、上海玖歌投资、上海乾瞻、申万菱信基金、苏银理财、太保资产、太平养老、泰康基金、天风证券、天惠投资、通晟资产、潼骁投资、卫宁私募、西部利得基金、溪牛投资、喜世润投资、襄阳市创新投资、新华基金、新华资产、鑫焱投资、信达澳亚基金、兴银理财、玄卜投资、易方达基金、益昶资产、益和源资产、银华基金、银叶投资、永安国富、永赢基金、于是资本、泽铭投资、长见投资、长江养老、长盛基金、招商信诺资产、招银理财、浙江英睿投资、浙商银行、真科基金、上海正心谷投资、中保投资、中海基金、中泰证券、中信保诚基金、中

	信保诚资产、中信建投基金、中信证券、中银基金、中庸资本、中再资产管理、Torito Capital
时间	2026年2月28日
地点	进门财经线上电话会
接待人员姓名	董事：谢思遥 董事会秘书：彭娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请介绍本次战略投资方向。</p> <p>本次战略投资规划，公司围绕“扩充先进产能”与“研发高端产品”两大核心主线展开。</p> <p>随着国内存储产业快速发展、市场需求持续旺盛，2025年至今公司已累计披露金额超20亿元的相关合同，充分反映下游客户对公司测试设备需求迫切。对此，公司计划在深圳市龙华区投资建设高标准产业化智造基地，在全力保障当前产品交付的基础上，进一步提升规模化、现代化、自动化的先进制造能力，以便更加敏捷地响应国内客户在技术升级与产能爬坡过程中的设备需求。</p> <p>在半导体领域，公司始终坚持“量产一代、在研一代、预研一代”的研发节奏，保持优势竞争地位。精智达在深圳龙华进行存储测试设备研发升级、上海设立高端芯片测试设备及前沿技术研发中心，正是为了多点催化研发成果、贴近产业前沿与客户需求，为未来更快的技术变革储备能力。</p> <p>二、请公司解析本次战略投资的区域布局规划</p> <p>公司以深圳为根基辐射大湾区，以上海为支点挺进长三角，通过双城布局深度融入国家半导体产业战略版图。</p> <p>深圳及大湾区，是国内半导体产业的重要增长极。根据深圳市发改委数据，2025年深圳半导体与集成电路产业规模首次突破3000亿元，带动设备行业规模增至356亿元，已形成从</p>

	<p>设计到制造、封测、设备、材料的全产业链协同格局。公司自成立以来便深耕深圳，深度融入深圳半导体产业发展，将充分利用区域产业集群优势，进一步提升高端测试设备的产业化能力，为大湾区打造半导体产业集群注入新动能。</p> <p>上海及长三角是我国集成电路产业的战略高地。2025 年上海集成电路产业规模预计突破 4600 亿元，汇聚全国约 40%的产业人才。本次在上海设立研发中心，将充分依托区域客户资源、技术储备和人才优势，与客户形成"协同研发—迭代验证—规模量产"的闭环，精准满足高端算力芯片测试设备和 HBM 测试设备等高端半导体测试设备广阔的市场需求。</p> <p>三、请公司解读 2025 年度业绩快报情况。</p> <p>2025 年，公司实现营业收入同比增长 40.65%。受益于公司持续加大研发投入，产品矩阵不断丰富完善，公司半导体测试设备市场份额进一步提升。相关具体数据请以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 3 月 3 日</p>